

バリ取りにお困りなら

XEBEC®カッティングファイバー 機械用

微細バリ取り、表面仕上げの自動化に最適

驚きの研削力!! セラミック砥石を線材にしました。



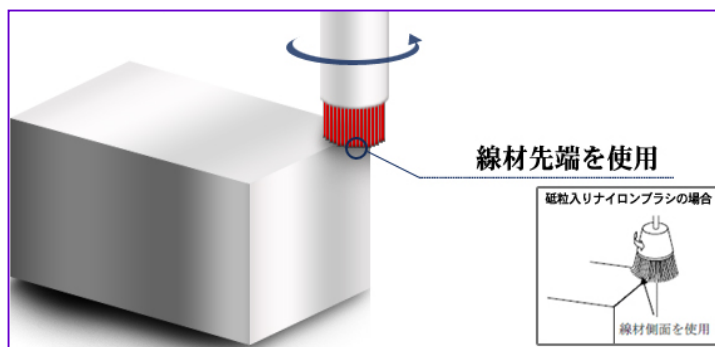
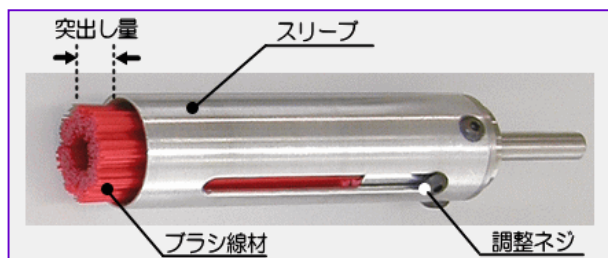
ここに注目

- マシニングセンタ、ロボット、専用機、ボール盤による加工に適しており、自動化が容易です。
- 線材先端の切れ目の自主作用により研削能力が高く、切れ刃が連続しているため、研削性能が安定しています。

用途

- 根源厚み0.1mm以下の微細バリ取り、エッジ処理
- 表面に出ている微細バリ取り
(1) 端面(管、継手、軸部等)のバリ取り、仕上げ
(2) 微小径穴加工(プレス、ドリル、レーザー加工)後のバリ取り
- 自動車エンジン部品等、エッジの品質を保ったまま、二次バリを発生せず、バリのみを除去したい精密部品
- 平面やなだらかな凹凸、曲面の研削、研磨。
- 自由曲面の表面処理には、ハンド工具をマシニングセンタでを使用することをお勧めします。

事例



ジーベック製品販売

柴 正徳

E-Mail : shiba-m@nodaki.jp

株式会社 ノダキ 東京営業所

〒170-0002

東京都豊島区巣鴨4-28-4 オーガスト80 2F

TEL 03-5567-1851 FAX 03-5567-1850

本社・浜松・刈谷・三重・九州・イゲタロイセンター

http://www.nodaki.jp

